

ここまできた最新レーザ加工の技術動向とその最前線！！

～新たな一步の可能性～

開催期日:平成19年2月14日(水)

申込締切:平成19年2月9日(金)

主催:(社)精密工学会

企画:事業部企画第2グループ

協賛(予定):RP 産業協会/アジア弁理士協会日本部会/SME 東京支部/応用物理学会/大田区産業振興協会/型技術協会/計測自動制御学会/研削砥石工業会/研磨布紙協会/自動車技術会/全国軽自動車協会連合会/全日本プラスチック製品工業連合会/素形材センター/ダイヤモンド工業協会/超硬工具協会/電気学会/電気加工学会/砥粒加工学会/日本液晶学会/日本オプトメカトロニクス協会/日本金型工業会/日本機械学会/日本木型工業会/日本規格協会/日本金属学会/日本金属プレス工業協会/日本光学測定機工業会/日本航空宇宙工業会/日本工具工業会/日本工作機械工業会/日本工作機器工業会/日本小型工作機械工業会/日本材料学会/日本自動車会議所/日本自動車研究所/日本自動車工業会/日本自動車部品協会/日本自動車部品工業会/日本セラミックス協会/日本塑性加工学会/日本鍛造協会/日本ダイカスト協会/日本鉄鋼協会/日本電機工業会/日本トライボロジー学会/日本半導体製造装置協会/日本表面科学会/日本弁理士会/発明協会東京支部/表面技術協会/プラスチック成形加工学会/レーザ加工学会/レーザー学会/光産業技術振興協会

精密・微細加工に加え、複雑3次元形状加工の要求や、さらには短納期が求められている各方面の製造現場では、日夜技術革新に取り組んでいることと思われます。そのようななか、最近のレーザ加工技術の発展には目覚ましいものがあり、その技術を上記製造現場の課題解決に活かすべく検討されてはいかがでしょうか。

本講習会では、コストダウン技術として、あるいは全く新しい可能性をもつ画期的な製造技術として進展著しい最新のレーザ加工技術にスポットライトを当てました。本講習会企画としては、4年ぶりのレーザ加工技術特集になります。講師陣には、最新研究の担い手である著名な大学教授に加え、産業界の第一線で顕著な活躍をされている技術者、経営者の方々をお招きし、具体的にわかりやすく最新のキーテクノロジー、技術動向、新たな可能性についてご講演いただきます。様々な可能性を秘めているレーザ加工は、日本の製造技術の革新技術として大いに期待できるところです。

レーザ加工技術の最新情報と、将来につながる最新研究概要の講演が皆様のもの作りのヒントになれば幸いです。景気も上向き傾向になりました今日、次期設備投資などのご検討にも役立つのではないかと考えております。関係者多数のご参加をお待ち申し上げております。なお、お席に限りがございますので、ご参加希望の方はお早めに精密工学会までお申し込み下さい。

日時:平成19年2月14日(水)、10時00分～16時40分

会場:工学院大学28階第1・2会議室(〒163-8677 東京都新宿区西新宿 1-24-2)

*新宿駅(JR 山手線, JR 中央線, JR 埼京線, 京王線, 小田急線, 東京メトロ丸の内線, 都営地下鉄新宿線)下車 西口より徒歩 5分

*都庁前駅(都営地下鉄大江戸線)直結 ☆会場 URL: <http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html>

司会 平井 聖児(ものづくり大学), 松井 伸介(日本電信電話株式会社), 安齋 正博(理化学研究所)

次第(予定)

時間	題目	内容	講師
	主催者挨拶		
10:00～11:00	総論 「レーザ加工の最新動向」	レーザ加工技術は、発振器等のハードと制御及びノウハウ等のソフトで支えられている。相互の発展は新しい可能性を生み、相乗効果をもたらす。ここでは、産業応用の立場から進化しているレーザ加工の最新動向を紹介する。	中央大学 研究開発機構 新井 武二
11:00～11:50	「最近の高出力固体レーザ&ファイバーレーザの進歩」	最近急速に進歩したファイバーレーザ及び固体レーザの状況を紹介します。ファイバーレーザでは最大50kWまでが開発されると共に、日本独自のファイバーディスクレーザが市販されるに至っている。一方、日本発の技術であるセラミックレーザが固体レーザを革新し、100kW出力の実現が間近に迫っている。これらの内容について紹介する。	電気通信大学 レーザー新世代研究センター 植田 憲一
11:50～13:00	昼食		
13:00～13:50	(調整中)	(調整中)	東成エレクトロニクス 技術部長 榊田 正之
13:50～14:40	「3次元レーザ加工機の生産性向上」	当初は、主に自動車関係の試作を中心に導入されてきた3次元レーザ加工機であったが、近年、量産を目的に導入されるユーザが増加している。そこで、「量産対応の3次元レーザ加工機の概要」、及び機上でのティーチング時間(加工プログラム作成時間)短縮の為に「3D用CAD/CAM」について紹介する。	日平トヤマ株式会社 レーザ事業部 アプリケーション技術部次長 今井 聡
14:40～15:00	休憩		
15:00～15:50	「産業応用のための高信頼フェムト秒レーザ開発と応用研究」	電子デバイス産業応用、バイオ・メディカル応用において微細で高品質な加工性能や特異な相互作用を可能とするフェムト秒レーザの実用化に関心が集まっている。生産ラインへの採用を目的としたフェムト秒レーザ装置の信頼性向上、応用技術研究について弊社の取り組みを紹介する。	サーベレーザ株式会社 取締役副社長 住吉 哲実
15:50～16:40	高出力ファイバーレーザの加工応用	近年、ディスクレーザ、ファイバーレーザに代表される高効率、高品質な次世代型固体レーザの高出力化が進展し、材料加工への応用検討が盛んに行われている。特に高出力ファイバーレーザに関して、弊社で実施した加工能力評価結果及び、その特徴を活かした加工応用検討例を紹介する。	株式会社レーザックス 事業部長 坪井 昭彦

定員:60名(先着順で定員になり次第締切ります)

参加費:会員(賛助会員および協賛団体会員を含む)20,000円、非会員30,000円【会員・非会員ともテキスト代含む】

学生会員 無料(ただし、資料ご入用の場合は、4,000円をご負担ください)

学生非会員 6,000円(テキスト代含む)

*参加費・テキスト代とも消費税を含みます。

資料:資料のみ、または聴講者で2冊以上ご希望の場合、1冊4,000円

申込方法:下記申込書に必要事項をご記入の上、郵送、FAXまたは学会ホームページにて受け付けます。

申込締切:平成18年10月6日(金)

申込先:(社)精密工学会

(〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-5-9 九段誠和ビル 2F, 電話 03-5226-5191, Fax 03-5226-5192)

(学会ホームページ <http://www.jspe.or.jp/service/seminar/seminar.html> からでも申込出来ます。)